

104 年中鋼公司博士級研究人員徵才啟事

本公司將招募下列博士級研究人員，需求資格條件及人數如下表，歡迎符合資格條件且有意願者應徵報名(限於 104 年 5 月 1 日以前能正式上班者報名)。

- ◎報名日期：**103 年 12 月 1 日 09:00 至 103 年 12 月 14 日 18:00 截止**，郵寄者以郵戳為憑(同仁親自持送相關文件者，收件期間同上)。
- ◎報名步驟：①請先至中鋼官網首頁 <http://www.csc.com.tw> 點選「104 年博士級研究人員徵才」，進行線上報名(應徵代號-可複選，最多得應徵 2 項)。
- ②線上報名完成後，請下載附件【博士級研究員應徵人員簡歷表】並將填寫完整之簡歷表併同下列各項相關文件，以書面郵寄方式寄送：「81233 高雄市小港區中鋼路 1 號，中鋼公司人力資源處任用組收」。
- (請依下載附件之電子檔案格式填寫，未依據該格式填寫者，視同初審不合格。
 - 請於信封上註明：寄件人姓名、應徵代號。

*本公司同仁之親友如有興趣報名者，請轉知應徵者務必於上述報名期間先進行線上報名，線上報名完成後，相關文件可由同仁親自持送送人力資源處任用組(小港廠區第一行政大樓 3 樓 301 室)。

- ◎檢具文件：1. 中鋼公司博士級研究員應徵人員簡歷表。
2. 博士畢業證書(影本)。
3. 博士論文。
4. 博士、碩士及大學成績單。(正本)
5. TOEIC 650 分以上或其他英文檢定證明文件影本(成績標準請參考甄選程序第 2 項第(2)點所列；若無，則免附，有檢附者，免英文測驗)。
6. 其他。

◎甄選程序：(請注意：第一至第三階段甄審結果，以 e-mail 通知為準。)

1. 第一階段：文件初審

初審合格者，通知參加後續各階段甄選程序。

2. 第二階段：英文測驗

- 有檢附英文檢定證明文件者，免英文測驗；另通知參加複審。
- 未檢附英文檢定證明文件者，通知參加英文測驗；合格者另通知參加複審。

◎免英文測驗之資格條件，需符合下列其中一項者：

- (1)在英語系國家取得大學以上學歷者。
- (2)通過以下英文檢定且成績分數達本公司規定，並檢具成績證明者()。

| 檢定名稱 | 成績分數 |
|---------------|------------------------------|
| TOEIC | 650 以上 |
| IELTS | 5 以上 |
| TOFEL(紙筆型態) | 500 以上 |
| TOFEL(電腦型態) | 170 以上 |
| 全民英檢(GEPT) | 中高級初試通過以上 |
| 外語能力測驗(FLOPT) | 三項筆試總分：217.5 以上 口試：S-2+以上 |

3. 第三階段：複審

個別進行 30 至 40 分鐘之專題報告，複審合格者另通知面試。

4. 第四階段：面試

面試合格者將以專函通知錄取、報到等事宜。

◎甄選未獲錄取者，所檢具之相關文件，本公司將統一於甄選過程全部結束後，將您的博士論文按通訊地址寄回給您。

◎104 年度博士級研究人員進用需求資料表◎

| 應徵代號 | 工作內容 | 主修科系及學歷 | 專業技能或經驗 | 需求人數 |
|------|---|--------------------|--|------|
| T11A | 電磁鋼片產品開發；產品品質改良改善；產品缺陷分析澄清與改善；產線量產組織與推動；研究設備管理。 | 材料、冶金、機械等相關科系博士 | 鋼鐵冶金、磁性材料、表面科學、顯微組織分析觀察、電子顯微鏡操作與應用、X光機操作與應用。 | 1 |
| T11B | 熱軋、鋼板產品合金設計及製程開發與改善。熱軋高強度鋼產品發展、鋼板產品發展、組織分析與控制。 | 冶金、材料、機械等相關科系博士 | 機械冶金、物理冶金、合金設計與熱機處理技術、金屬材料顯微組織分析及控制技術、金屬相變態及組織控制技術、熱處理組織分析及控制技術、銲接冶金分析及控制技術、材料破壞性質分析。 | 1 |
| T11C | 棒線產品合金設計及製程開發與改善。超細線開發、彈簧鋼發展、組織分析與控制。 | 冶金、材料、機械等相關科系博士 | 機械冶金、物理冶金、合金設計與熱機處理技術、金屬材料顯微組織分析及控制技術、金屬相變態及組織控制技術、熱處理組織分析及控制技術、材料破壞性質分析 | 1 |
| T13A | 碳熱還原煉鐵製程技術開發 | 冶金、材料、化工、機械等相關科系博士 | 碳熱還原反應工程、高溫金屬冶煉技術、高溫燃燒熱流工程 | 1 |
| T15A | 軋延製程分析、應力分析 | 機械、應力、航太、動機等相關科系博士 | <ul style="list-style-type: none"> • 固體力學、塑性力學 • 數值分析 • 有限元素分析 • 程式語言：C/C++，VB。 | 1 |
| T16A | 鋼品超音波、渦電流、磁漏檢測及其他 NDT 檢測 | 材料等相關科系博士 | <ul style="list-style-type: none"> • 非破壞檢測技術 • 程式設計 | 1 |
| T16B | 嵌入式機器視覺系統研發 | 電機、電子、資工等相關科系博士 | <ul style="list-style-type: none"> • 影像識別演算法理論與相關分析技術 • 類比與數位訊號處理電路設計 • DSP 平台與嵌入式系統研發與設計技術 | 1 |

| 應徵代號 | 工作內容 | 主修科系及學歷 | 專業技能或經驗 | 需求人數 |
|------|---|-----------------|--|------|
| T16C | 系統控制應用研發 | 機械、工工等相關科系博士 | <ul style="list-style-type: none"> •系統控制 •系統分析 •控制理論、 | 1 |
| T16D | 電磁材料應用研究與技術推廣 | 電機、機械等相關科系博士 | <ul style="list-style-type: none"> •馬達設計分析 •電磁模擬與耦合分析 •馬達特性檢測分析 •電磁材料特性量測分析 •馬達驅動控制 | 1 |
| T18A | 塑性加工電腦模擬、塑性加工製程技術開發 | 機械等相關科系博士 | 固體力學、塑性力學、有限元素分析、模具設計與製造、CAD/CAE 電腦輔助設計與電腦輔助工程分析 | 1 |
| T63A | 鈦合金產品開發 | 冶金、材料、機械等相關科系博士 | <p>機械冶金、物理冶金、冶金熱力學。</p> <p>合金設計與熱機處理技術。</p> <p>金屬材料顯微組織分析及控制技術。</p> | 2 |
| T64A | 環保觸媒開發、觸媒活性測試、觸媒物性鑑定、環保觸媒量產、舊觸媒再生及廢觸媒有價金屬回收 | 化學、化工或材料等相關科系博士 | 具有觸媒配製及活性測試經驗，可以操作 GC、SEM、XRD、XPS、TPD、TPR 及 BET 等觸媒物性分析設備及解讀能力，若具有有價金屬回收經驗則更佳。 | 1 |
| T65A | 廢熱回收應用技術開發及製程操作優化應用技術開發 | 機械或化工等相關科系博士 | <p>製程熱流場模擬及操作最佳化</p> <p>具有與工作內容相關實務經驗且有具體成果者優先</p> | 1 |
| T66A | 鋁合金軋延產品及相關製程技術開發 | 材料、機械等相關科系博士 | <ul style="list-style-type: none"> •物理冶金、機械冶金 •材料顯微組織分析 •軋延製程研究、材料破壞解析 •熟悉鋁合金系統為佳 | 2 |

附表

中鋼公司博士級研究員應徵人員簡歷表

應徵類別代號：_____。_____。(最多 2 項)

填表日期：_____年_____月_____日

錄取後可報到日期：_____年_____月_____日

請貼上
2 吋半身
個人近照

個人資料：

姓名：_____ 性別：男 女

出生年日：_____年_____月_____日 婚姻狀況：未婚 已婚

兵役狀況：役畢 未役 免役

國籍：_____

聯絡電話：_____ 手機：_____

E-mail: _____

通訊地址：_____

學歷資料：

| 學歷別 | 校名 | 系所別 | 入學年月 | 畢業年月 | 學位 |
|-----|----|-----|------|------|----|
| 博士 | | | / | / | |
| 碩士 | | | / | / | |
| 大學 | | | / | / | |

在學平均成績：

| 學年別 | 第一學年 | | 第二學年 | | 第三學年 | | 第四學年 | | 第五學年 | |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| | 上學期 | 下學期 |
| 博士 | | | | | | | | | | |
| 碩士 | | | | | | | | | | |
| 大學 | | | | | | | | | | |

專長能力：

| | |
|------|--|
| 專長領域 | |
| 電腦技能 | |
| 其他證照 | |

語文能力：(如有通過 TOEFL/TOEIC/IELTS/全民英檢及其他檢測合格者，請註明項目和成績)

| 語文別 | 聽 | 說 | 讀 | 寫 | 檢測項目及成績 |
|-----|---|---|---|---|---------|
| 英文 | | | | | |
| 日文 | | | | | |
| 其他 | | | | | |

工作經歷：(工作內容及離職原因請簡述，如無工作經歷可免填)

| 工作期間起迄 | 公司名稱 | 職稱 | 主要工作內容 | 離職原因 |
|--------|------|----|--------|------|
| / ~ / | | | | |
| / ~ / | | | | |
| / ~ / | | | | |

請依序附上下列之紙本資料：

一、自傳：(可用中文或英文撰寫，最多 2 頁為限)

二、應徵資格說明：

(請簡述：自我專長、符合應徵職務之理由、期望之工作內容、自我評價和期許，以 1 頁為限)

應徵職務之優先順序：1. _____ 。 2. _____ 。

(同時應徵 2 個工作職務者，請註明。)

三、博士論文摘要：

(請簡述：緣由、目標、研究方法、重要研究結果與技術成就，最多 3 頁為限)

四、碩士論文摘要：

(請簡述：緣由、目標、研究方法、重要研究結果與技術成就，最多 1 頁為限)

五、國內外期刊及研討會論文發表清單：(請加註 EI/SCI)

六、國內外專利申請清單：(如無，可免填)

七、國內外得獎紀錄：(如無，可免填)

八、附件清單檢核表：(請依序附上下列必需繳附之資料，如無，請填“0”)

1. 役畢或免役證明影本 1 份。

2. 博士學位論文正本 1 份。

3. 博士、碩士、大學各學期成績單正本各 1 份。

4. 具代表性之國內外期刊論文 _____ 份。(最多 3~5 份)

5. 國內外專利證書影本 _____ 份。

6. 國內外得獎證書影本 _____ 份。

7. 其他證明文件 _____ 份：(請依個人狀況填列)

(1) 英語檢定證明影本 _____ 份。

(2) 電腦證照影本 _____ 份。